

MicroSense® BP1

自动晶圆厚度和平整度测量系统

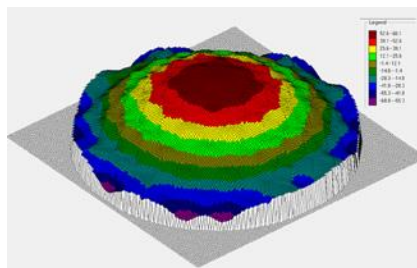
测量具有任何电气或光学特性的晶圆或衬底

MicroSense BP1晶圆测量系统采用了两个专利的高分辨率非接触式自动定位背压探头，能够精确测量晶圆厚度、平面度和形貌。BP1系统非常灵活，可以测量各种不同的晶圆材料及晶圆厚度。晶圆表面光洁度对测量没有影响——BP1可以测量锯切、研磨的或抛光的晶圆。

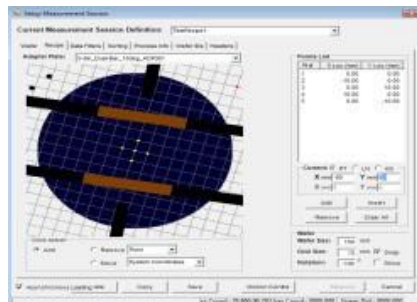
- **复合半导体晶圆的厚度和总厚度变化 (TTV)**——系统非常灵活，可处理多种不同的材料和键合晶圆，例如GaAs和GaN（在蓝宝石、SiC或硅之上）和InP，以及硅和锗。
- **薄晶圆的厚度**——特殊的晶圆支架可用于测量薄至300微米的晶圆厚度。晶圆被拉至平面状态以便准确测量厚度和TTV
- **玻璃或陶瓷衬底**——测量玻璃晶圆、硅上玻璃晶圆或特殊用途的玻璃和陶瓷衬底



在非接触式空气轴承平台上进行非接触式双传感器晶圆测量



3D 晶圆测绘



灵活的菜单设置

MicroSense® BP1自动晶圆厚度和平整度测量系统

主要功能

晶圆厚度测量范围宽-300 μ m至1.7mm-圆形或方形

MicroSense BP1旨在测量薄至300 μ m和厚至1.7mm的晶圆，而无需耗费时间调整系统。晶圆和衬底可以是圆形或方形，最大可达200mm。多种晶圆支架可供选择，我们将根据所需的厚度和直径推荐一个或多个晶圆支架。

系统配置

BP1有2种配置——手动加载台式系统或配有机械臂和两个晶圆盒的自动加载系统

精确的晶圆测量

- 0.5 μ m 绝对厚度测量精度，<300 μ m翘曲
- 使用集成校准标准的自动校准背压传感器——无需主晶圆
- 高重复性的非接触式空气轴承平台，用于可重复的晶圆定位

系统选项

- Windows 10基础平台
- 适用于各种晶圆直径和厚度的晶圆支架
- 晶圆预对准器
- OCR识别器——一侧或两侧
- SECS/GEM
- 离线数据再处理软件

优势

- 直接、独立于材料的高灵敏度测量
- 根据材料厚度自动调节
- 用于精确可靠并可重复的测量的专利背压传感探头
- 高灵敏度2D和3D晶圆形态测绘输出
- 集成的系统内自动校准——无需主晶圆，无产能损失
- 自动装载和测量长达200mm的圆形或方形基材
- 适于生产的设计——无需洁净室

KLA 支持

保持系统产能是KLA良率优化解决方案不可或缺的一部分。该领域内的工作包括系统维护、全球供应链管理、降低成本和缓解系统过时、系统搬运、性能和产能提升以及认证设备的转售。

©2021 KLA 公司。所有品牌或产品名称可能是其各自公司的商标。KLA保留更改硬件或软件规格的权力，恕不另行通知

KLA Corporation
One Technology Drive
Milpitas, CA 95035
www.kla.com

美国印刷

2021年7月26日 第1.0版